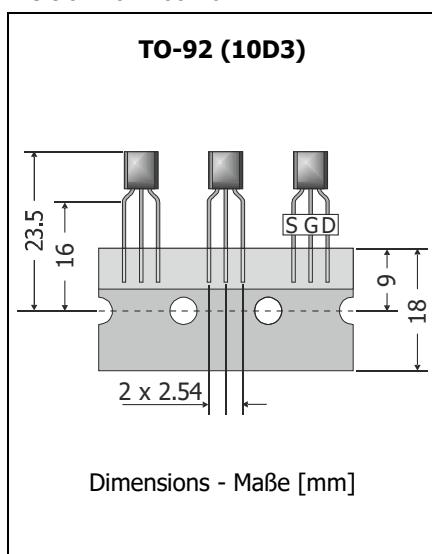


2N7000
N-Channel Enhancement Mode FET
N-Kanal FET – Anreicherungstyp

I_D = 200 mA V_{DSS} = 60 V
R_{DS(on)1} < 5 Ω P_{tot} = 350 mW
T_{jmax} = 150°C

Version 2017-08-16

**Typical Applications**

Signal processing, Logic level converter, Drivers
Commercial grade ¹⁾

Features

Fast switching times
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals ¹⁾

**Mechanical Data ¹⁾**

Taped in ammo pack (Raster 2.54)	4000	Gegurtet in Ammo-Pack (Raster 2.54)
Weight approx.	0.18 g	Gewicht ca.
Case material	UL 94V-0	Gehäusematerial
Solder & assembly conditions	260°C/10s MSL N/A	Löt- und Einbaubedingungen

Typische Anwendungen

Signalverarbeitung, Pegelwandler, Treiberstufen
Standardausführung ¹⁾

Besonderheiten

Schnelle Schaltzeiten
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien ¹⁾

Mechanische Daten ¹⁾**Maximum ratings ²⁾**

Drain-Source-voltage – Drain-Source-Spannung	V _{DSS}	60 V
Drain-Gate-voltage – Drain-Gate-Spannung $R_{GS} \leq 1 \text{ MΩ}$	V _{DGR}	60 V
Gate-Source-voltage – Gate-Source-Spannung DC $t_p < 50 \text{ μs}$	V _{GSS}	$\pm 20 \text{ V}$ $\pm 40 \text{ V}$
Power dissipation – Verlustleistung	P _{tot}	350 mW ³⁾
Drain current continuos – Drainstrom Peak Drain current – Drain-Spitzenstrom	I _D I _{DM}	200 mA 500 mA
Operating Junction temperature – Sperrsichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur	T _j T _s	150°C -55...+150°C

Grenzwerte ²⁾**Characteristics****Kennwerte**

T _j = 25°C	Min.	Typ.	Max.
Drain-Source breakdown voltage – Drain-Source Durchbruchspannung I _D = 10 μA	V _{(BR)DSS}	60 V	
Drain-Source leakage current – Drain-Source Leckstrom V _{DS} = 48 V, V _{GS} = 0 V V _{DS} = 48 V, V _{GS} = 0 V, T _j = 125°C	I _{DSS}	1 μA 1 mA	
Gate-Body leakage current – Gate-Substrat Leckstrom V _{GS} = ±15 V	±I _{GSS}	10 nA	

- 1 Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches
- 2 T_A = 25°C, unless otherwise specified – T_A = 25°C, wenn nicht anders angegeben
- 3 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from case
Gültig wenn die Anschlussdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Characteristics**Kennwerte**

		T _j = 25°C	Min.	Typ.	Max.
Gate-Threshold voltage – Gate-Source Schwellspannung		V _{GS(th)}	0.8 V	–	3 V
V _{GS} = V _{DS} , I _D = 1 mA					
Drain-Source on-voltage – Drain-Source-Spannung		V _{DS(on)}	–	2.5 V 0.45 V	–
V _{GS} = 10 V, I _D = 500 mA V _{GS} = 4.5 V, I _D = 75 mA					
Drain-Source on-state resistance – Drain-Source Einschaltwiderstand		R _{DS(on)}	–	–	5 Ω 6 Ω
V _{GS} = 10 V, I _D = 500 mA V _{GS} = 4.5 V, I _D = 75 mA					
Forward Transconductance – Übertragungssteilheit		g _{FS}	100 mS	–	–
V _{DS} = 10 V, I _D = 200 mA					
Input Capacitance – Eingangskapazität		C _{iss}	–	60 pF	–
V _{DS} = 25 V, f = 1 MHz					
Output Capacitance – Ausgangskapazität		C _{oss}	–	25 pF	–
V _{DS} = 25 V, f = 1 MHz					
Reverse Transfer Capacitance – Rückwirkungskapazität		C _{rss}	–	5 pF	–
V _{DS} = 25 V, f = 1 MHz					
Turn-On Delay Time – Einschaltverzögerung		t _{on}	–	10 ns	–
V _{DD} = 15 V, R _L = 30 Ω, I _D = 0.5 A, V _{GS} = 10 V, R _G = 25 Ω					
Turn-Off Delay Time – Ausschaltverzögerung		t _{off}	–	10 ns	–
V _{DD} = 15 V, R _L = 30 Ω, I _D = 0.5 A, V _{GS} = 10 V, R _G = 25 Ω					
Thermal resistance junction to ambient Wärmewiderstand Sperrsicht – Umgebung		R _{thA}	< 357 K/W ¹)		

Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)

Haftungsausschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

¹ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from case
Gültig wenn die Anschlussdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden